

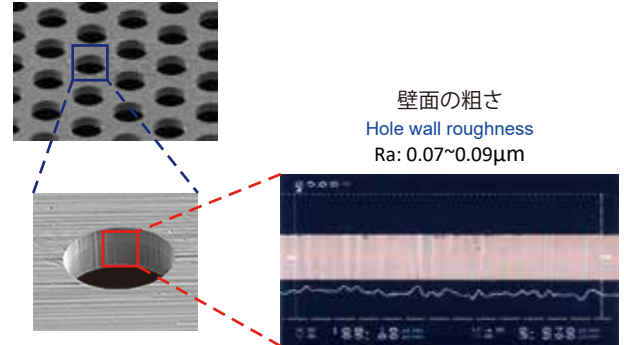
メタルマスク (アディティブマスク)

Stencil

電鍍技術を使用した「はんだボール搭載用」、「フラックス/ペースト印刷用」、「蒸着用」などの各種メタルマスク
Various stencils with electroforming technology such as for solder balls printing, for flux/paste printing and for vapor deposition.

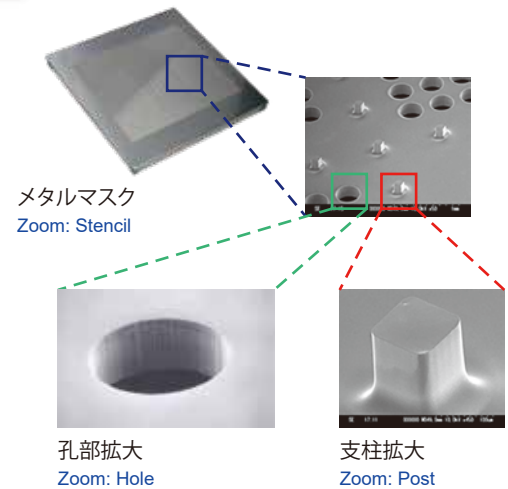
フラックス / ペースト印刷用マスク Stencil for Flux / Paste printing

- 優れた垂直断面形状
Excellent vertical cross section (No side edges)
- 板厚より小さな孔の形成が可能
Possible to make smaller holes than plate thickness
- 自社フォトリソ技術による高精度な孔寸法を実現
High precision hole measurement by our photolithography technology
- 自社電鍍技術により、優れた耐久性を有しためっき形成が可能 (硬度: 約HV500)
Possible to make plating with excellent endurance by our EF² technology (Hardness: about HV500)
- 特殊加工技術による板厚のコントロールが可能
Possible to adjust plate thickness by special processing technology

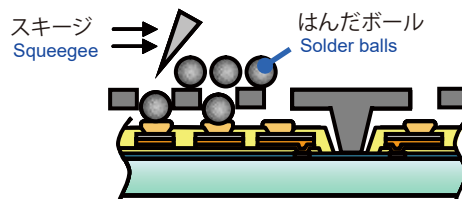


はんだボール搭載用マスク Stencil for solder balls printing

- Φ50μm以上 (量産時) のはんだボールを搭載可能 (試作時: Φ30μm以上)
Possible to place phi 50μm and bigger solder ball (Prototype: phi 30μm and bigger)
- はんだボール一括搭載を実現
Batch placement of solder balls
- 特殊支柱形成により、優れた搭載率を実現
Excellent placement ratio of micro solder ball by special post
- 金属製だけでなく樹脂製の特殊支柱も可能
Possible to make metal post and resin post



はんだボール搭載のイメージ
Image of solder ball printing



仕様 Specifications

	メタルサイズ Metal sheet size	有効エリア Effective area	ピッチ (量産時) Pitch (MP)	板厚 Thickness
フラックス/ペースト印刷用マスク Stencil for Flux / Paste printing	Max. 550x550mm	350x350mm	Min. 90μm	Min. 15μm
はんだボール搭載用マスク Stencil for solder ball printing	Max. 550x636mm			